

한미반도체 (042700)

본딩의 축복이 끝이 없네 끝이 없어

투자의견

BUY(신규)

목표주가

83,000 원(신규)

현재주가

55,700 원(10/12)

시가총액

5,421 (십억원)

반도체 소재/부품/장비 임소정_sophie.yim@eugenefn.com

- 2분기 실적은 매출 491억원, 영업이익 112억원으로 시장 컨센서스에 부합, 전년대비 각각 60%, 75% 감소.
- MSVP(microSAW & VISION PLACEMENT) 장비와 본딩 장비 매출이 큰 폭 증가한 가운데, 특히 지난해 수주를 받은 TSV공정 TC Bonder 장비의 매출이 인식된 점이 매출 증가를 견인.
- 2023년 연간 실적은 매출 1,898억원, 영업이익 442억원으로 전망. HBM 시장을 선도하고 있는 주요 고객사의 공격적인 투자로 한미반도체의 TC Bonder 장비와 신규 본딩 장비 매출 증가가 기대됨.
- 연초 대비 주가가 약 4배 상승한 점은 투자자 입장에서 부담스러운 수준임은 사실. 하지만 본딩 장비 제품군 확대와 MSVP 장비의 새로운 시장 진출을 통해 향후 종합 후공정 장비사로의 도약이 기대되며 2025년에는 매출 5,000억원대 전망. 투자의견 'BUY' 및 목표주가 83,000원으로 제시.

주가(원,10/12)	55,700
시가총액(십억원)	5,421

발행주식수	97,339천주
52주 최고가	63,300원
최저가	11,150원
52주 일간 Beta	1.78
60일 일평균거래대금	2,050억원
외국인 지분율	11.0%
배당수익률(2023F)	0.4%

주주구성	
곽동신 (외 9인)	55.5%
국민연금공단 (외 1인)	6.5%

주가상승	1M	6M	12M
상대기준(%)	7.7	176.5	353.5
절대기준(%)	5.5	173.7	366.1

	현재	직전	변동
투자의견	BUY	BUY	-
목표주가	83,000	-	-
영업이익(23)	44	-	-
영업이익(24)	115	-	-

12월 결산(십억원)	2022A	2023E	2024E	2025E
매출액	328	190	352	515
영업이익	112	44	115	158
세전손익	128	249	119	162
당기순이익	92	192	91	123
EPS(원)	948	1,974	933	1,268
증감률(%)	-10.2	108.3	-52.8	35.9
PER(배)	12.1	29.0	61.4	45.2
ROE(%)	25.0	40.1	15.1	17.9
PBR(배)	2.9	9.8	8.7	7.5
EV/EBITDA(배)	8.4	101.6	43.9	32.4

자료: 유진투자증권



I. 실적 Review 및 Preview

2Q23 Review

한미반도체의 2 분기 실적은 매출 491 억원(+85.0%QoQ, -60.2%YoY), 영업이익 112 억원(+438.6%QoQ, -74.5%YoY)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스에 부합한 수준이며, 전분기대비로는 1 분기에 대한 기저효과가 반영되었다. 지속되는 칩 메이커 기업들의 낮은 가동률과 설비 투자 축소 기조로 전년대비로는 여전히 부진한 수준이다. 장비별로 나누어보면 TC Bonder 를 비롯한 본딩 장비 부문의 매출이 4 배 이상 증가했는데, HBM 생산을 위해 주요 고객사가 지난해 수주한 실적이 반영된 것으로 추정된다. 높은 마진율과 기술적 경쟁력이 강점인 MSVP 의 매출도 전분기대비 2 배 이상 증가했다.

3Q23 & FY2023 Preview – 다품종 대량생산의 시대

3 분기 실적은 매출 549 억원, 영업이익 147 억원으로 전망한다. 주요 고객사를 비롯한 칩 메이커 기업들의 감산 기조가 길어질 것으로 예상되고, 이에 따른 설비 투자 감축의 영향을 받아 2023 년 연간 매출은 1,898 억원, 영업이익 442 억원을 기록할 것으로 전망한다. 부진한 업황으로부터 자유로울 수는 없겠으나, 매출 영역이 확대되고 있다는 점은 고무적이다.

대표적인 시스템 반도체향 장비 기업에서 TSV 공정의 핵심 장비인 TC Bonder 를 납품하는 메모리향 장비 기업으로 외형을 키우고 있다는 점에서 올해보다는 2025 년의 실적이 기대된다. 한미반도체가 메모리 칩인 HBM 시장 개화의 수혜를 받을 수 있던 이유는 HBM 자체가 '비메모리적 접근'을 필요로 하기 때문이다. 다품종 소량 생산이 아닌 다품종 다량 생산의 시기가 도래했다. 이에 최첨단 전 공정 기술에 집중했던 메모리 시장에서 후공정의 중요성이 대두되면서 자연스럽게 시스템 반도체 후공정 장비의 대표 기업을 찾게 되는 것이다. 현재 HBM 시장을 주도하는 주요 고객사와는 지난 2015 년부터 함께 연구·개발을 해왔고, 최근에는 관련 장비만을 생산하는 'Bonder Factory'를 증설하며 함께 드라이브를 걸고 있다. 따라서 TSV 공정을 위한 TC Bonder 매출 기여도가 큰 폭 상승할 것으로 예상되는 바, 종합 후공정 장비 업체로의 도약이 기대된다.

도표 144. 한미반도체 세부 실적 추정

(십억원, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	63	123	80	61	27	49	55	59	373	328	190	352
YoY	-11%	13%	-12%	-40%	-58%	-60%	-32%	-3%	45%	-12%	-42%	85%
QoQ	-38%	95%	-35%	-24%	-56%	85%	12%	8%				
MS/VP	39	73	47	36	12	31	34	36	217	195	112	205
Bonding 장비	8	5	8	5	1	5	5	6	17	26	18	52
Camera Module	1	10	4	3	7	2	2	2	36	17	13	13
EMI Shield	0	6	1	2	0	0	0	0	35	8	1	1
Spare & Kit	9	16	13	9	6	8	10	10	41	47	34	59
기타	7	13	8	6	1	3	3	4	26	34	11	20
매출비중												
MS/VP	62%	59%	59%	59%	44%	62%	62%	61%	37%	60%	57%	58%
EMI Shield	13%	4%	10%	8%	4%	10%	10%	11%	3%	9%	9%	14%
Camera Module	1%	8%	4%	5%	25%	4%	4%	4%	7%	5%	9%	4%
Spare & Kit	0%	5%	1%	3%	0%	1%	1%	1%	28%	2%	1%	0%
Bonding 장비	14%	13%	16%	15%	23%	17%	18%	18%	14%	15%	19%	17%
기타	10%	11%	10%	10%	5%	6%	6%	6%	12%	10%	6%	6%
영업이익	21	44	32	15	2	11	15	16	122	112	44	115
OPM	34%	36%	40%	24%	8%	23%	27%	27%	33%	34%	23%	33%
YoY	10%	20%	4%	-59%	-90%	-75%	-54%	12%	84%	-9%	-60%	161%
QoQ	-40%	106%	-27%	-55%	-86%	439%	32%	10%				
영업외손익	-2	-7	7	-17	131	23	-3	-3	-18	-20	148	-24
순이익	20	37	39	-3	133	34	12	13	104	92	192	91
NPM	31%	30%	48%	-5%	502%	69%	22%	22%	28%	28%	101%	26%
YoY	-4%	33%	45%	적전	579%	-8%	-69%	흑전	108%	-12%	107%	-55%
QoQ	-34%	88%	5%	적전	흑전	-74%	-65%	8%				
EPS(원)									1,056	948	1,974	933
YoY									117%	-10%	108%	-53%

자료: 한미반도체, 유진투자증권

II. Valuation

한미반도체의 목표주가는 RIM(잔여이익모델)으로 산출한 내재가치를 바탕으로 83,000 원으로 제시한다. 목표주가는 Rf(Risk Free Rate) 3.5%, Market Risk Premium 4.0%, beta 1.4 등의 가정을 반영하여 산출하였다.

연초 대비 한미반도체의 주가가 약 4 배 상승한 점은 분명한 부담 요인이다. HBM 시장이 아직 메모리 전체 시장의 약 3%만을 차지한다는 점도 유의미한 규모의 매출이 발생하기까지는 시차가 있을 것으로 보여진다.

하지만 NVIDIA 가 H100 프로세서의 출하량을 내년에는 올해 대비 3~4 배 확대할 것이라는 계획이 전해지면서, 한미반도체도 이에 대한 낙수효과를 기대해볼 수 있다. TSMC 의 CoWoS 패키징 과정에서 진입할 수 있는 시장이 열려 있다는 점 또한 고려했을 때, 실적이 점차 개선될 것이라는 사실은 분명하다. 주요 고객사 수주 공시는 시장의 예상보다 규모가 다소 작다고 보여질 수 있다. 하지만 개화하는 시장에서 가장 빠르게 그 시장의 메인 플레이어 기업에 본격적인 수주를 시작하는 단계이다. 또한 칩 제조 업체뿐만 아니라 대형 파운드리와 OSAT 업체로의 장비 진입이 예상된다. 시스템 반도체 전문 후공정 기업에서 메모리 시장의 가장 선단 공정 영역까지 진출하는 바, HBM 시장 확대의 수혜 강도가 높을 것으로 판단된다.

도표 145. 한미반도체 RIM 모델

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	CV
(억원)														
지배주주자본(기말)	3,468	3,901	5,675	6,389	7,428	8,624	9,972	11,518	13,372	15,405	17,792	20,372	23,652	
YoY	34.9%	12.5%	45.5%	12.6%	16.3%	16.1%	15.6%	15.5%	16.1%	15.2%	15.5%	14.5%	16.1%	
지배주주자본(평균)	3,020	3,685	4,788	6,032	6,908	6,403	9,298	10,745	12,445	14,388	16,598	19,082	22,012	
YoY	26.7%	22.0%	30.0%	26.0%	14.5%	-7.3%	45.2%	15.6%	15.8%	15.6%	15.4%	15.0%	15.4%	
지배주주 순이익	1,044	923	1,922	908	1,234	1,461	1,636	2,127	2,552	3,190	3,819	4,604	5,553	
FROE	34.6%	25.0%	40.1%	15.1%	17.9%	22.8%	17.6%	19.8%	20.5%	22.2%	23.0%	24.1%	25.2%	
Rf	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Rp	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
Beta (기업리스크)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
COE	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%	9.10%
FROE-COE	25.49%	15.94%	31.04%	5.95%	8.77%	13.71%	8.49%	10.69%	11.41%	13.07%	13.91%	15.03%	16.13%	
Residual Income	770	587	1,486	359	606	878	790	1,149	1,419	1,881	2,308	2,868	3,550	3,550
YoY	166.2%	-23.7%	153.1%	-75.8%	68.7%	49.5%	-10.0%	45.5%	23.6%	32.5%	22.7%	24.2%	23.8%	
PV Factor	1.000	0.918	1.000	0.918	0.843	0.774	0.711	0.653	0.600	0.551	0.506	0.464	0.426	168,411
PV of RI		539	1,486	330	511	680	562	750	851	1,035	1,167	1,331	1,514	65,927

계속성장률 : 6.80%

베타 : 1.4

Rf (한은 기준금리): 3.50%

Rp : 4.00%

PV Factor : 0.918

초기 주주가치 5,675

추정된 RI의 현재가치 8,730

계속가치의 현재가치 +) 65,927

주주가치 합계 추정치 (억원) 80,332

발행주식수 (천주) /) 97,339

추정 주당가치 (원) 82,528

현재 주가 55,700

상승 여력 48.2%

자료: 유진투자증권

도표 146. 한미반도체 Peer Evaluation

(백만\$, 배, %)		한미반도체	BE Semiconductor	Toray Industries	Towa	ASM International
시가총액		3,843	8,140	8,010	748	20,401
매출액	2021	254	761	18,413	398	2,539
	2022A	150	610	17,106	333	2,734
	2023F	256	831	18,061	394	3,055
	2024F	305	1,110	19,024	442	3,558
영업이익	2021	87	310	806	74	666
	2022A	39	218	761	55	697
	2023F	80	336	968	77	802
	2024F	98	481	1,079	92	1,005
OPM	2021	34.1	40.7	4.4	18.6	26.2
	2022A	26.0	35.8	4.5	16.5	25.5
	2023F	31.2	40.5	5.4	19.5	26.2
	2024F	32.0	43.3	5.7	20.9	28.2
순이익	2021	72	253	539	54	410
	2022A	134	184	526	39	638
	2023F	80	285	669	54	723
	2024F	99	410	768	64	873
P/E	2021	12.2	18.7	16.6	7.1	NM
	2022A	28.2	44.1	14.8	19.4	30.1
	2023F	47.7	27.8	11.8	14.0	27.7
	2024F	38.2	19.3	10.3	11.7	22.7
P/B	2021	2.9	7.1	0.8	1.1	NM
	2022A	9.6	18.9	0.7	2.2	5.9
	2023F	8.4	17.8	0.7	2.0	5.2
	2024F	6.9	12.9	0.7	1.7	4.5
EV/EBITDA	2021	8.4	13.0	7.9	4.1	14.9
	2022A	82.0	33.1	8.4	11.5	23.5
	2023F	43.3	22.0	7.4	8.3	20.2
	2024F	35.9	15.7	6.7	7.1	16.5
ROE	2021	25.0	38.6	5.0	16.7	15.6
	2022A	32.9	32.8	4.9	11.4	20.7
	2023F	19.1	63.9	6.2	13.2	19.4
	2024F	19.3	74.7	6.7	14.0	21.2
EPS 성장률	2021	(11.1)	(18.1)	(13.6)	(9.7)	NM
	2022A	100.2	(29.0)	9.1	(21.6)	NM
	2023F	(40.8)	58.5	25.5	38.7	8.8
	2024F	24.8	44.1	14.8	19.4	22.1

자료: Bloomberg, 유진투자증권

Ⅲ. 투자 포인트

HBM 관련 설비 투자 확대의 수혜

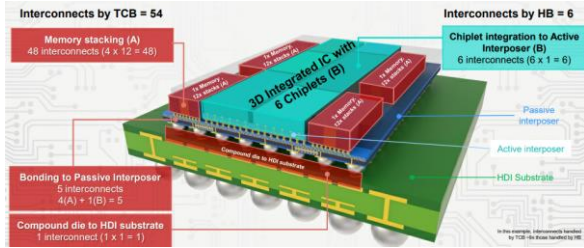
칩 제조 기업들의 HBM 관련 투자는 곧 시장의 확대로 이어지고, 이는 한미반도체에게 장비 납품 기회 확대를 의미한다. 지난 컨퍼런스 콜을 통해 주요 고객사인 SK 하이닉스는 어려운 업황 속에서 HBM 으로의 공정 전환에 집중된 설비 투자를 진행할 것으로 밝혔다. 현재 4 세대 HBM3 를 단독 생산하고 있는 가운데 지난 8 월에는 5 세대인 HBM3E 샘플을 고객사에게 공급하여 시장을 또다시 선점할 것으로 예상된다. 이에 발맞춰 NAND 생산지로 알려진 충북 청주의 M15 팹에 HBM 의 핵심 공정인 TSV 패키징 라인을 신설한다는 계획이 구체화된다면, 한미반도체의 장비가 도입될 가능성이 높다.

AMD 와 NVIDIA 를 고객사로 보유한 삼성전자는 천안 공장에 HBM 제조 라인을 신설할 예정이며, 생산능력을 2024 년 말까지 2 배 확대할 것으로 밝혔다. 후발 주자인 마이크론은 HBM3 를 건너뛰고 2024 년 HBM3E 양산을 목표로 하고 있다. 이러한 칩 메이커 기업들의 지속적인 투자와 생산은 시장의 확장과 HBM 의 상용화로 이어질 것이며, 장기적으로 한미반도체의 장비가 앞서 언급한 기업들에 진입할 가능성을 높일 것으로 예상된다.

CoWoS 생태계 강화의 수혜

NVIDIA 의 AI GPU 생산 병목 현상의 원인으로 CoWoS 패키징 지원 부족이 언급되면서, 관련 OSAT 업체로의 낙수효과가 기대된다. Amkor 의 경우 NVIDIA 로부터 2.5D 패키징 지원을 요청받아 파트너십 인증 단계에 접어들었다. ASE 는 NVIDIA 의 AI GPU 패키징을 지원하는 OS 프로세스에 대한 주문을 획득, CoW 인증 절차에 있다. 두 OSAT 기업에 이미 MSVP 장비를 납품한 이력이 있는 한미반도체에게 이러한 흐름에 맞춰 TC Bonder 장비 납품의 기회도 주어질 것으로 판단한다.

도표 147. TSMC의 CoWoS 패키징



자료: ASMPT, 유진투자증권

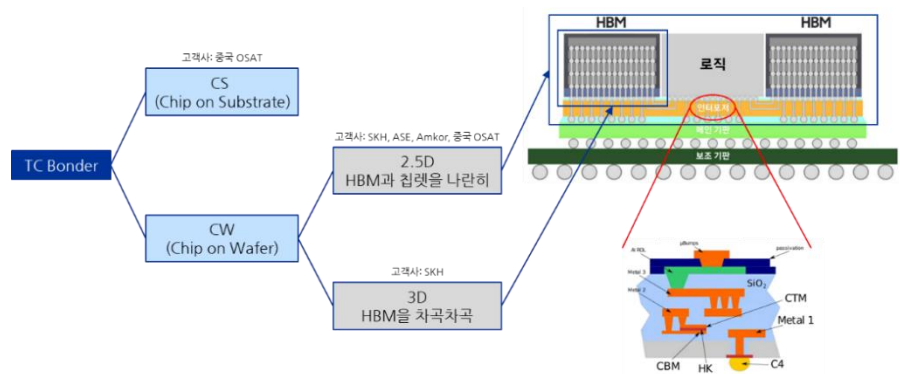
도표 148. 어드밴스드 패키징 관련 기업

	제조사	관련 장비사
HBM	SK 하이닉스 삼성전자 마이크론	한미반도체 ASMPT Shinkawa
Chiplet	TSMC	BESI
HBM과 Chiplet를 인터포저에 본딩	ASE Amkor	한미반도체 ASMPT

자료: 유진투자증권

뿐만 아니라 현재 고객사에 납품되고 있는 3D 패키징 장비 외에도 인터포저 위에 칩을 본딩하는 2.5D TC Bonder-CW(Chip on Wafer) 장비도 2024년부터 납품될 것으로 예상된다. 추가로 3D 패키징 장비는 AI 반도체 자체 개발에 힘쓰고 있는 중국 OSAT 고객사향으로 매출이 발생할 것으로 전망한다. 결론적으로 TSMC의 CoWoS 구조 내에 새로운 영역 진입은 기존 고객사 내 점유율 확대와 한미반도체의 외형적 성장으로 이어질 것으로 예상된다.

도표 149. TSMC의 CoWoS와 한미반도체의 TC Bonder



자료: 유진투자증권

지난 8월 말과 9월 초 한미반도체는 SK하이닉스와 단일 판매 공급 계약 체결을 공시했다. 계약 금액은 각각 416 억원, 596 억원이며 모두 2024 년 매출로 인식 될 예정이다. 해당 수주 공시를 통해 AI/ML 용 엔비디아의 GPU 수요 확대와 이에 따른 SK 하이닉스의 HBM 생산 증가, 핵심 장비인 한미반도체의 TC Bonder 까지 수혜가 이어진다는 것을 확인할 수 있다.

도표 150. 한미반도체 주요 단일판매 및 공급계약체결 공시 현황

계약기간 시작일	계약기간 종료일	매출 기준년도	금액(억원)	매출액대비(%)	체결 계약 장비	고객사
2023-09-27	2024-04-21	2024	596.1	18.2	HBM TC Bonder	SK 하이닉스
2023-08-31	2024-04-05	2024	415.6	12.7	HBM TC Bonder	SK 하이닉스
2023-06-12	2023-09-20	2023	14.2	0.4	-	유니마이크론
2023-06-12	2023-10-24	2023	12.2	0.4	-	인피니언 Asia Pacific
2023-05-30	2023-08-31	2023	79.2	2.4	MSVP, EMI 실드	중국 OSAT 업체
2022-11-11	2023-09-08	2023	33.7	0.9	-	난야 PCB
2022-07-07	2022-12-30	2022	22.7	0.6	HBM3 TC Bonder	SK 하이닉스
2022-07-06	2023-01-05	2023	26.1	0.7	-	코리아써킷
2022-07-01	2022-12-12	2022	27.9	0.8	MSVP	난야 PCB
2022-07-01	2022-10-10	2022	13.2	0.4	-	코보 China
2022-06-27	2022-10-01	2022	26.3	0.7	-	인피니언 말레이시아
2022-05-17	2022-09-30	2022	36.2	1.0	-	ASE
2022-05-11	2023-01-15	2023	30.0	0.8	MSVP	난야 PCB
2022-04-29	2022-10-31	2022	35.0	1.0	-	유니마이크론
2022-01-13	2022-05-31	2022	32.9	1.3	MSVP	중국 PCB 업체
2021-12-24	2022-04-08	2022	2.9	0.1	-	ASE
2021-12-24	2022-04-29	2022	14.2	0.6	-	ASE
2021-12-24	2022-11-30	2022	25.6	1.0	-	대만 OSAT 업체
2021-12-07	2023-01-31	2023	81.7	3.2	-	난야 PCB
2021-12-06	2022-05-06	2022	47.9	1.9	MSVP	코리아써킷
2021-12-02	2022-04-30	2022	67.7	2.6	-	ASE
2021-11-10	2022-11-18	2022	36.1	1.4	-	유니셈 중국
2021-08-13	2022-03-31	2022	44.9	1.7	HBM TC Bonder	SK 하이닉스
2021-08-12	2022-02-28	2022	32.9	1.3	-	ASE
2021-08-10	2021-12-30	2021	50.2	2.0	-	SPIL
2021-04-13	2021-10-08	2021	28.3	1.1	-	마이크론 말레이시아
2021-03-31	2021-12-031	2021	27.3	2.3	-	JCET
2021-03-10	2021-11-30	2021	117.5	9.8	HBM TC Bonder	SK 하이닉스
2021-02-17	2021-09-30	2021	14.2	1.2	-	NXP 대만
2021-01-20	2021-10-22	2021	23.8	2.0	-	화천과기
2021-01-19	2021-05-30	2021	126.1	10.5	-	Amkor 한국

자료: 한미반도체, 유진투자증권

한미반도체(042700.KS) 재무제표

대차대조표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
자산총계	429	455	638	735	846
유동자산	250	270	283	374	477
현금성자산	50	104	151	148	223
매출채권	113	81	74	115	129
재고자산	86	80	54	106	120
비유동자산	180	186	355	361	369
투자자산	67	69	239	249	259
유형자산	108	113	112	109	107
기타	5	4	4	4	3
부채총계	82	65	70	97	103
유동부채	81	63	67	93	99
매입채무	45	25	29	55	61
유동성이자부채	0	1	1	1	1
기타	36	36	37	37	37
비유동부채	2	2	4	4	4
비유동이자부채	0	1	1	1	1
기타	1	2	3	3	3
자본총계	347	390	568	639	743
지배지분	347	390	568	639	743
자본금	13	13	13	13	13
자본잉여금	51	51	56	56	56
이익잉여금	283	325	498	569	673
기타	1	1	0	0	0
비지배지분	0	0	0	0	0
자본총계	347	390	568	639	743
총차입금	1	2	2	2	2
순차입금	(49)	(101)	(149)	(147)	(221)

현금흐름표

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
영업현금	52	110	68	29	107
당기순이익	104	92	192	91	123
자산상각비	6	9	9	8	8
기타비현금성손익	35	54	(357)	(9)	(9)
운전자본증감	(71)	(7)	74	(67)	(21)
매출채권감소(증가)	(32)	11	40	(41)	(14)
재고자산감소(증가)	(39)	1	22	(52)	(13)
매입채무증가(감소)	9	(20)	6	26	6
기타	(9)	2	5	0	0
투자현금	(65)	(18)	29	(12)	(13)
단기투자자산감소	0	(13)	23	(0)	(0)
장기투자증권감소	(37)	0	13	(6)	(7)
설비투자	25	9	11	5	6
유형자산처분	0	1	0	0	0
무형자산처분	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)
재무현금	(20)	(51)	(41)	(19)	(19)
차입금증가	(0)	(1)	(1)	0	0
자본증가	(20)	(50)	(40)	(19)	(19)
배당금지급	20	30	19	19	19
현금 증감	(32)	41	60	(3)	75
기초현금	81	50	91	150	148
기말현금	50	91	150	148	222
Gross Cash flow	146	155	12	96	128
Gross Investment	136	12	(79)	79	34
Free Cash Flow	10	143	92	17	94

자료: 유진투자증권

손익계산서

(단위:십억원)	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
매출액	373	328	190	352	515
증가율(%)	45.0	(12.2)	(42.1)	85.3	46.3
매출원가	193	143	95	160	252
매출총이익	180	185	94	191	262
판매 및 일반관리비	58	73	50	76	105
기타영업손익	31	27	(31)	52	38
영업이익	122	112	44	115	158
증가율(%)	83.7	(8.6)	(60.5)	160.6	36.8
EBITDA	129	121	53	124	165
증가율(%)	77.1	(6.4)	(55.7)	131.4	33.9
영업외손익	14	16	205	4	5
이자수익	0	1	3	1	2
이자비용	0	0	0	0	0
지분법손익	6	0	78	3	3
기타영업외손익	8	15	125	0	0
세전순이익	136	128	249	119	162
증가율(%)	107.6	(6.2)	94.8	(52.0)	35.9
법인세비용	32	36	57	29	39
당기순이익	104	92	192	91	123
증가율(%)	108.3	(11.7)	108.3	(52.8)	35.9
지배주주지분	104	92	192	91	123
증가율(%)	108.3	(11.7)	108.3	(52.8)	35.9
비지배지분	0	0	0	0	0
EPS(원)	1,056	948	1,974	933	1,268
증가율(%)	116.9	(10.2)	108.3	(52.8)	35.9
수정EPS(원)	1,056	948	1,974	933	1,268
증가율(%)	116.9	(10.2)	108.3	(52.8)	35.9

주요투자지표

	2021A	2022A	2023F	2024F	2025F
주당지표(원)					
EPS	1,056	948	1,974	933	1,268
BPS	7,012	4,008	5,831	6,563	7,631
DPS	300	200	200	200	200
밸류에이션(배, %)					
PER	17.9	12.1	29.0	61.4	45.2
PBR	2.7	2.9	9.8	8.7	7.5
EV/ EBITDA	14.1	8.4	101.6	43.9	32.4
배당수익율	1.6	1.7	0.3	0.3	0.3
PCR	12.9	7.2	449.4	58.0	43.4
수익성(%)					
영업이익율	32.8	34.1	23.3	32.8	30.6
EBITDA이익율	34.5	36.8	28.1	35.1	32.2
순이익율	28.0	28.2	101.3	25.8	24.0
ROE	34.6	25.0	40.1	15.1	17.9
ROIC	46.3	33.7	15.9	39.1	45.0
안정성 (배, %)					
순차입금/자기자본	(14.1)	(26.0)	(26.3)	(23.0)	(29.8)
유동비율	309.6	427.6	424.1	402.6	479.2
이자보상배율	3,341.4	923.9	537.9	1,501.3	2,053.2
활동성 (회)					
총자산회전율	1.0	0.7	0.3	0.5	0.7
매출채권회전율	3.9	3.4	2.4	3.7	4.2
재고자산회전율	5.6	3.9	2.8	4.4	4.6
매입채무회전율	8.9	9.3	6.9	8.4	8.9